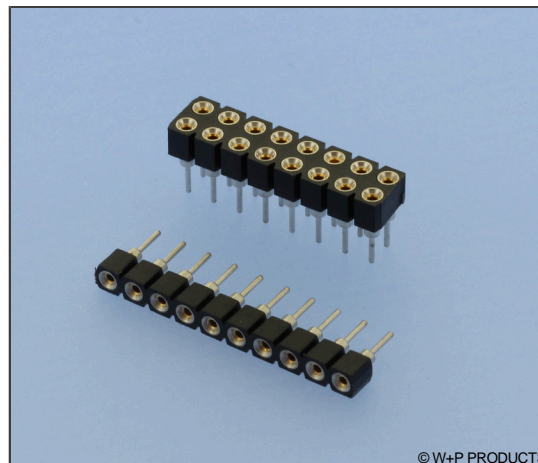


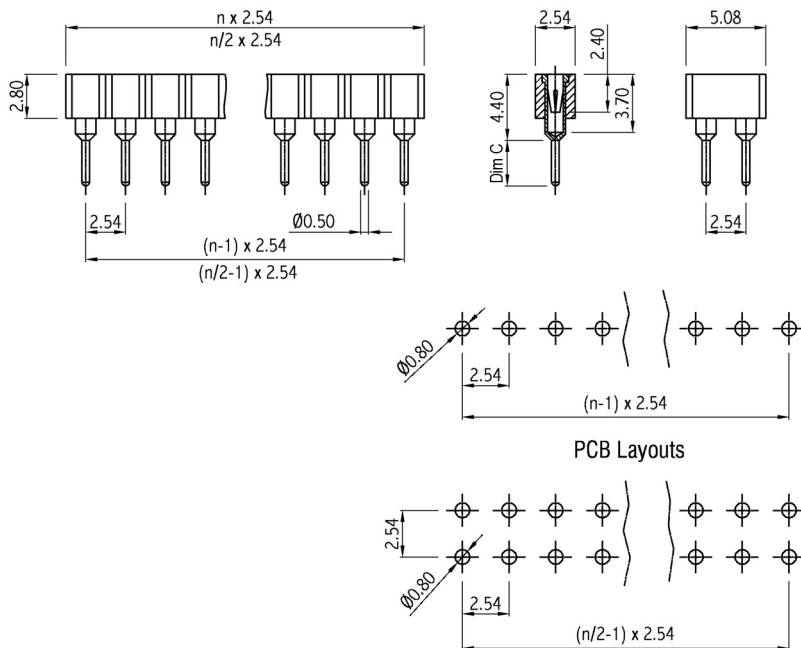
### Technische Daten / Technical Data

Gehäuse/Abdeckung/Hebel	Thermoplast, nach UL94 V-0
Case/Cover/Actuator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Hülse: Messing gedreht
<i>Contact Material</i>	Feder: 4-Lamellen-Clip, Beryllium-Kupfer
	<i>Sleeve: screw machined brass</i>
	<i>Clip: 4-Finger-Clip, Beryllium-Copper</i>
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni
Contact Surface	Acc. to options (see below), over Ni
Durchgangswiderstand	< 10 mΩ
Contact Resistance	< 10 mΩ
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
Insulation Resistance	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit	1 kV RMS
Test Voltage	1 kV RMS
Nennspannung	100 V RMS / 150 V DC
Voltage Rating	100 V RMS / 150 V DC
Nennstrom	1 A
Current Rating	1 A
Temperaturbereich	-55 °C ... +125 °C
Temperature Range	-55 °C ... +125 °C
Verarbeitung	Wellenlötverfahren
Processing	Wave soldering



© W+P PRODUCTS

Für Rundstifte Ø0,40-0,56mm  
oder Vierkantstifte 0,25x0,45mm.  
For Ø0.40-0.56mm round pins  
or 0.25x0.45mm rectangular pins.



PCB Layouts

<b>Series</b>	<b>Contacts*</b>	<b>Rows*</b>	<b>Sleeve Plating</b>	<b>Clip Plating*</b>	<b>Dim C*</b>
<b>182</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>50</b>	<b>00</b>	<b>..</b>
182 IC-Leiste IC-Strip	01-64 Einreihig Single row 02-64 Zweireihig Double row	1 Einreihig Single row 2 Zweireihig Double row	50 Verzinkt (Standard) Tin plated (Standard)	00 Vergoldet Gold plated 10 Vergoldet 0,25µm (Option) 0,25µm gold plated (Option) 30 Vergoldet 0,75µm 0,75µm gold plated	[ ] C=2.90mm 41 C=4.10mm 50 C=5.00mm 55 C=5.45mm 70 C=7.00mm

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -  
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** -  
please replace by your specifications.

# Informationen zum Wellen-Lötverfahren

## Wave Soldering Information

### Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

#### Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.

Empfohlenes Wellenlötprofil:



### Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150 °C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	217 °C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur $T_P$	max. 8m

### Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150 °C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature $T_L$	217 °C
Duration above $T_L$	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature $T_P$	260±5 °C
Duration Peak Temperature	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	max. 8min

